

北京赛微电子股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司及旗下子公司拟向中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）申请合计不超过10亿元人民币的集团综合授信额度，其中公司拟向建设银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度；公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）拟向建设银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度；公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）拟向建设银行申请不超过5亿元的综合授信额度，期限均为12个月，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。公司拟为上述子公司申请银行授信事项提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以该等子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，该子公司免于支付担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，此次对外担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京赛积国际科技有限公司

1、基本情况

（1）名称：北京赛积国际科技有限公司

- (2) 统一社会信用代码：91110115MA01RBXF8Y
- (3) 类型：有限责任公司(法人独资)
- (4) 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街1号院3号楼2层101-07室
- (5) 法定代表人：杨云春
- (6) 注册资本：88000万人民币
- (7) 成立日期：2020年05月19日
- (8) 营业期限：2020年05月19日 至 2050年05月18日
- (9) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

赛积国际为公司的全资子公司。

经查询，赛积国际不属于失信被执行人。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
资产总计	147,908.50	149,880.42
负债总计	61,289.66	63,699.83
所有者权益	86,618.84	86,180.60
项目	2023年度	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	35,404.62	2,614.11
营业利润	2,552.23	-584.32
净利润	2,494.09	-438.24

赛积国际为公司全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，偿还能力具有保障。

(二) 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司

1、基本情况

- (1) 名称：赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司

(2) 统一社会信用代码：91110302MA002JAU90

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

(5) 法定代表人：杨云春

(6) 注册资本：210526.32万人民币

(7) 成立日期：2015年12月15日

(8) 经营范围：半导体器件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工制造半导体器件；产品设计；销售电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

赛莱克斯北京为公司控股子公司。

经查询，赛莱克斯北京不属于失信被执行人。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
资产总计	337,358.59	311,492.30
负债总计	177,551.42	153,702.11
所有者权益	159,807.16	157,790.19
项目	2023年度	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	17,392.77	6,948.78
营业利润	-16,732.80	-3,521.70
净利润	-10,623.37	-2,016.98

赛莱克斯北京为公司控股子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，偿还能力具有保障。

三、担保的主要内容

公司全资子公司赛积国际拟向建设银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度；公司控股子公司赛莱克斯北京拟向建设银行申请不超过 5 亿元的综合授信额度，用于子公司日常经营、项目建设及业务拓展。

现公司拟为上述子公司申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与

期限等以该子公司根据资金使用计划与建设银行签订的最终协议为准，该等子公司免于支付担保费用。

四、董事会意见

本次担保对象赛莱克斯北京为公司控股子公司，公司持有其 71.5% 股权，其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。赛莱克斯北京的第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司未按持股比例提供同比例担保。

国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立于 2014 年 9 月，出资人包括财政部、国开金融、中国烟草等单位，主要运用多种形式对集成电路行业内企业进行投资，充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业；国家集成电路产业基金同时是公司及控股子公司赛莱克斯北京的第二大股东，一直支持公司半导体业务的发展，其受限于章程条款的约束，无法为公司控股子公司赛莱克斯北京的本次申请银行授信事项提供担保。

董事会认为：子公司本次拟向建设银行申请合计不超过 7.5 亿元的综合授信额度，有利于其日常经营、项目建设及业务拓展。公司本次为子公司申请银行授信提供担保有利于该等子公司筹措资金，满足其经营活动对资金的需求。赛积国际为公司全资子公司，赛莱克斯北京为公司控股子公司，均具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为子公司此次申请银行授信提供担保，担保有效期限与综合授信期限以该等子公司与银行签订的最终授信协议为准，该等子公司免于支付担保费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为合并报表范围内的担保。公司及子公司（含本次）的累计担保金额为 221,220 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.85%，实际担保余额为 86,628.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.78%；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024年6月26日